

承认书

Specification for approval

客户名称 : _____

Customer




产品型号 : GY-3535BP1-10500-LG45M

Product Part No.

日期 : _____

Date

客户确认 Confirmation Approved		

工程部 Engineering Department		
核准 Approved	审核 Checked	制定 Prepared
		



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

SHENZHEN GUANGMAI ELECTRONICE CO., LTD.

地址 (Add): 宝安福永永福路与重庆路交叉口金港工业园 B 栋 4-5 楼

电话 (Tel): 86-0755-23499599

传真 (Fax): 86-0755-23497717

Copyright © 2016 GMDZ . All rights reserved . Subject to change without notice

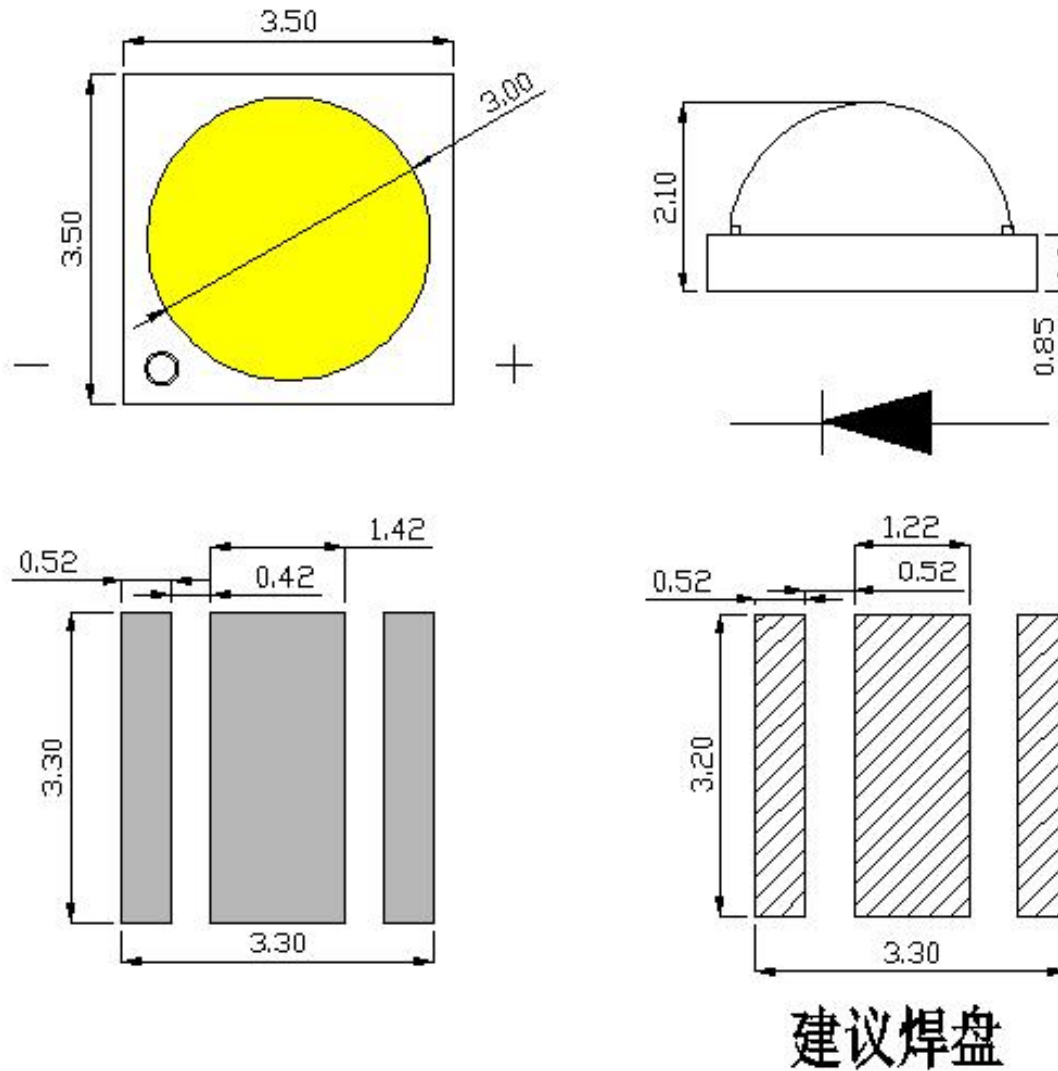
Features 产品特征:

- Low voltage operation (低电压工作)
- Instantly light (瞬间点亮)
- Long operating life (超长工作时间)

Applications 产品应用:

- The uv curing (ink、glue、manicure) 紫外固化 (油墨、胶水、美甲)
- Industrial application(exposure、bonding) 工业应用 (曝光、黏合)
- Disinfection sterilization (消毒杀菌)
- Anti-counterfeiting recognition (barcode、yanchao、Criminal identification)
防伪识别 (验钞、刑事鉴定、条码)

■ Package Dimensions 封装外形尺寸



Notes: All dimensions in mm tolerance is ± 0.1 mm unless otherwise noted.
除非另有说明，以上尺寸以 mm 为单位，公差在 ± 0.1 mm。

■ Absolute Maximum Ratings(At TA =25°C) 极限参数

Parameter	Symbol	Rating	Unit
DC Forward Current (正向电流)	I_F	700	mA
Peak pulse Current* (脉冲电流)	I_{FP}	1000	mA
Power Dissipation (功率)	P_D	3	W
Reverse Voltage (反向电压)	V_R	5	V
Reverse Current (反向电流)	I_R	10	μA
Operating Temperature Range (工作温度)	T_{OPR}	-30 ~ +75	$^{\circ}C$
Storage Temperature Range (储存温度)	T_{STG}	-40 ~ +85	$^{\circ}C$
LED Junction Temperature (结点温度)	T_J	120	$^{\circ}C$

Notes: 1. 1/10 Duty Cycle 0.1ms Pulse Width. (脉冲宽度 0.1ms, 占空比 1/10)

■ Electrical/Optical Characteristics--White (At TA=25°C) 光电特性参数

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Avg.	Max	Units
Forward Voltage (正向压降)	V_F	$I_F=500mA$	3.60	--	4.00	V
Thermal Resistance Junction To Board (热阻)	$R\theta_{J-B}$	$I_F=500mA$	--	8	--	$^{\circ}C/W$
Radiant Flux 光功率	Φ_e	$I_F=500mA$	500		600	mW
Peak wavelength 峰值波长	λ_p	$I_F=500mA$	365		375	nm
Temperature Coefficient of Forward Voltage (正向压降之温度系数)	$\Delta V_F/\Delta T$	$I_F=500mA$	--	-2	--	mV/ $^{\circ}C$
Reverse Current (反向漏电流)	I_R	$V_R=5V$	--	--	10	μA
Viewing Angle ^[1] (发光角度)	$2\theta_{1/2}$	$I_F=500mA$	--	120	--	Deg

part No. Description 产品型号说明

A B- C D E- F G H- I J K
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1: 公司名称 The name of the company

G 代表光脉

2: 支架材质 Scaffold material

S:SMD	E:EMC	Y:氧化铝	T:陶瓷	D:氮化铝	F:倒装
-------	-------	-------	------	-------	------

3: 产品尺寸 Product size

2835	5730	3030	5050	3535	5054
------	------	------	------	------	------

4: 功率 power

A:1W	B:2W	C:3W	D:5W	E:10W	F:15W	G:20W
------	------	------	------	-------	-------	-------

5: 颜色编码 Color code

紫光 purple		蓝光 blue		绿光 green		黄绿光 yellow green		黄光 yellow		橙红光 orange		红光 red	
编 码	波段	编 码	波段	编 码	波段	编 码	波段	编 码	波段	编 码	波段	编 码	波段
P1	360-370	B1	440-450	G1	480-490	E1	540-550	Y1	580-585	C1	600-605	R1	615-620
P2	370-380	B2	450-460	G2	490-500	E2	550-555	Y2	585-587.5	C2	605-610	R2	620-625
P3	380-390	B3	460-465	G3	500-510	E3	555-560	Y3	587.5-590	C3	610-615	R3	625-630
P4	390-400	B4	465-470	G4	510-515	E4	560-565	Y4	590-592.5	C4		R4	630-640
P5	400-410	B5	470-480	G5	515-520	E5	570-575	Y5	592.5-595	C5		R5	640-650
P6	410-420	B6		G6	520-525	E6	575-580	Y6	595-597.5	C6		R6	650-660
P7	420-430	B7		G7	525-530	E7		Y7	597.5-600	C7		R7	730
P8	430-440	B8		G8	530-540	E8		Y8		C8		R8	850
P9		B9		G9		E9						R9	940
白光 white		W3	5000k 以下色温 CCT<5000K, 2000-4500K、200K 分档, 4500-5000K 一档。										
		W6	5000k 以上色温 CCT>5000K, 5000-8000、500K 分档, 8000-10000K、1000K 分档; 10000-20000K、5000K 分档, 20000-30000K 一档。										
双色		DW	三色		T1			四色			T2		

6: 芯片数量 Number of chips 1 代表 1pcs 芯片, 2 代表 2pcs 芯片.....

7. : 发光角度编码 Viewing angle code

编码	角度
0	120
1	140
3	30
5	120/160
6	60
7	175
9	90

8. : 光功率 Radiant Flux

编码	光功率
100	100-200
.....	
500	500-600
.....	
1000	1000-1100
.....	
1500	1500-1600
.....	
2000	2000-2200
.....	

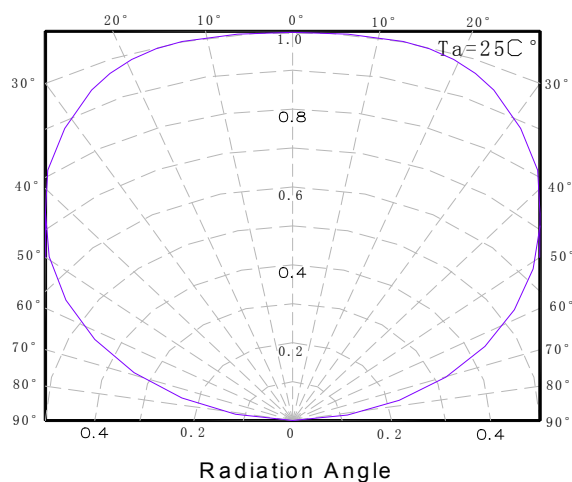
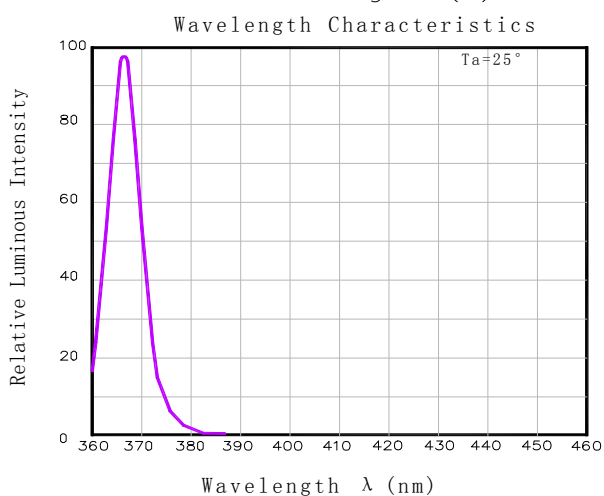
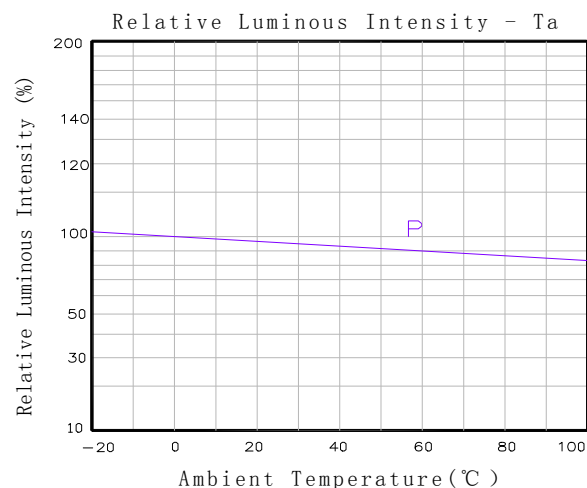
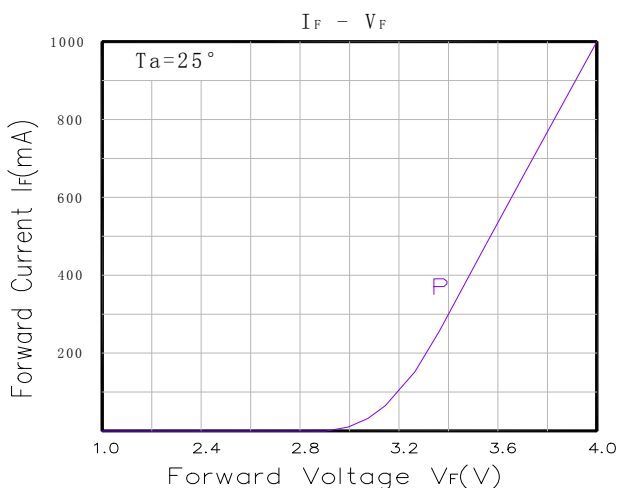
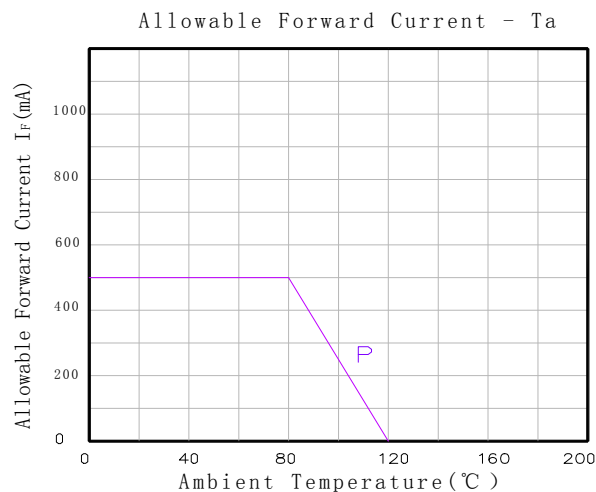
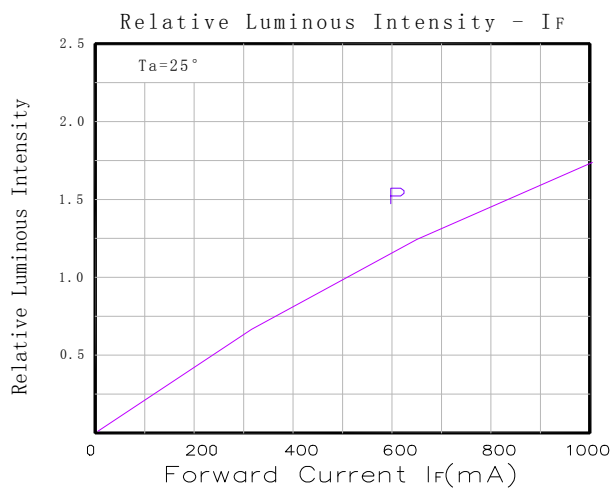
9. : 芯片厂家代码 The chip manufacturer code

10. : 芯片尺寸代码 The chip size code

11. : M 代表硅胶模腔封装 (Silicone encapsulation), P 代表平面封装 (Plane), S 代表球面封装 (Spherical)

■ Typical Optical/Electrical Characteristics Curves 典型光电参数曲线

($T_a=25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Noted)



■ Reliability test standards 可靠性实验标准

类别 Type	测试项目 Test Item	参考标准 REF. Standard	测试条件 Test condition	持续时间 Duration	取样数 Sample count	允收数 Accept
环境 测试	温度循环 Temperature Cycle	JESD22-A104-A	-40℃~25℃~100℃~25℃ 30min,5min,30min,5min	循环 100 次 100 cycles	22	0/22
	冷热冲击 Thermal shock	JESD22-A106	-40℃~100℃ 30min, 30min	循环 100 次 100 cycles	22	0/22
	高温储存 High Temperature Storage	JEITA ED-4701 200 201	TA=100℃ ± 5℃	1000 Hrs	22	0/22
	低温储存 Low Temperature Storage	JEITA ED-4701 200 202	TA=-40℃ ± 5℃	1000 Hrs	22	0/22
	高温/高湿储存 Humidity Heat Storage	JIS C 7021 (1977)B-11	Ta=60℃ RH=85%	1000Hrs	22	0/22
寿命 试验	寿命测试 Life test	JESD22-A108-A	Ta=25℃ If=500mA	1000Hrs	22	0/22
	高温/高湿寿命测试 High humidity Heat life test	JESD22-A101	Ta=60℃ RH=85% IF=500mA	1000Hrs	22	0/22
破坏 性试 验	耐焊性 Resistance to soldering Heat	JESD22-A113	IR soldering 245℃/10sec	1 time	22	0/22

产品使用说明

一、储存/使用:

1. 为避免吸潮建议将产品贮存在放有干燥剂的干燥柜中，贮存温度为：5℃~30℃，湿度：≤60%HR；
2. 储存六个月之后建议重新分光分色后使用，防止光电参数发生变化。
3. 密封储存六个月以上的产品使用前，建议干燥，干燥条件为：65℃±5℃10 个小时；
4. 产品开封 24h 内需使用完毕，否则需 65℃ 烘烤 4-6h 后再过回流焊；
5. 请勿以任何尖锐物体（例如镊子）按压硅胶表面。请勿在硅胶表面留下指印。硅胶体正面法向承受按压力需小于 2 牛顿，按压次数小于 3 次；硅胶体侧面承受按压力小于 1.5 牛顿，按压次数小于 3 次。正确拾取材料（如下图）

二、回流焊后，不允许快速冷却。

三、采用烙铁手工焊接，条件为 300℃/3sec。

四、禁止焊接在变形 PCB 板上。

五、产品不得接触水、油、有机溶液。

六、产品使用工作电流大小值应考虑 LED 结温。

七、重新包装未使用的产品置防潮袋密封好之后贮存在干燥的地方。

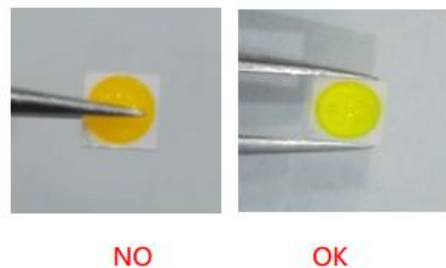
八、产品外观尺寸可更改而不另行通知。

九、防静电要求：使用产品时，必须戴防静电手环或防静电手套，所有设备、装置、机台必须有效接地。

十、当 LED 工作时，推荐 PCB 板的温度不要超过 60℃。

十一、回流焊注意事项[如需回流焊产品]

1. 在铝基板上刮导热锡膏，刮锡膏前锡膏要顺时针搅拌 10-15 分钟，把铝基板放在刮锡膏工装上，锡膏要刮的均匀，厚度要适宜；
2. 刮锡膏钢网需做成十字架，好让空气流通，避免锡膏抬起造成 LED 光源散热不良；
3. 注意灯要装平，LED 光源的两个管脚有要装在铝基板的焊盘位上；
4. 刮好锡膏的铝基板在 2 小时内要全部装好光源，光源的装在铝基板后，作业员要自检光源是否装好（不能有反向，光源底部悬空）要倾斜 45 度角检查每颗光源；
5. 回流焊机的温度设置参考（建议不超过 200 度）



焊接剂 = 低温无铅锡	焊接剂 = 无铅锡
温度上升斜率= 4°C/s 最大	温度上升斜率=4°C/s 最大
预热温度 = 100°C ~150°C	预热温度 = 150°C ~180°C
预热时间 = 60s 最大	预热时间 = 90s 最大.
温度下降斜率为 6°C/s 最大	温度下降斜率为 6°C/s 最大
峰值温度 = 180°C 最大	峰值温度 = 220°C 最大
在峰值温度±5°C时间不能超过 10s	在峰值温度±5°C时间不能超过 10s
超过 160°C 的温度的时间不能超过 60s	超过 200°C 的温度的时间不能超过 60s

6. 过完回流焊后透镜与填充胶会分层，产生镜面属正常现象，不影响任何使用及性能；

7. 过完回流焊后要检查光源是否在焊盘位置上，不能有偏心现象，否则在上二次配光透镜时会把线拉断，造成开路。

十二、防硫化、氯化、溴化等处理:

在密闭、高温的环境中，灯具内可能含硫/氯/溴等物质，这些硫、氯和溴元素会挥发成气体并腐蚀 LED 光源。因为 LED 封装硅胶具有多孔性结构，与光源镀银层发生硫化反应。LED 光源出现硫化反应后，产品功能区会黑化，光通量会逐渐下降直至微亮，色温出现明显漂移，LED 光源最终会失效。建议先进行灯具排硫测试，确保 LED 光源在无硫/氯/溴等物质环境进行工作。